





ENABLING THE DIGITAL WORLD

ASM Advanced Packaging

Automobilindustrie: Treiber für neue Prozesse

AUTOMOBILINDUSTRIE TREIBER FÜR NEUE PROZESSE



Elektroantriebe, autonomes Fahren – die Automobilindustrie setzt auf modernste Elektronik. Als zentrale Technologie gilt Advanced Packaging. ASM hat sich in diesem Wachstumsmarkt als technologisch führendes Unternehmen etabliert – auch mit hochspezialisierten Tochterunternehmen wie NEXX, ALSI und AMICRA.

Auf der productronica 2019 widmet ASM dem Advanced Packaging einen eigenen, großen Standbereich. Drei Cluster zeigen exemplarische Gesamtlösungen für die Bereiche Elektrifizierung, Sensorik und schnelle Datenübertragung.



SIPLACE TX micron – Kombination von Chips und SMD in einem High-Speed-Platziervorgang



SIPLACE CA – High-Volume-Fertigung von Small-Scale-Radarsensoren in einem kostengünstigen Fan-out Wafer-Level-Package – jetzt mit Crack-Die- und Chipped-Die-Erkennung



Autopia – Lösungen für das Active Alignment von Linsen in optischen Systemen in Autokameras



AMICRA CoS – hochpräzises Chip-on-Substrate Bonding





Elektrifizierung

Die Leistungselektronik erfordert neue Verbindungsund Herstellungsverfahren. ASM präsentiert komplette Lösungsketten für Printing, Die-Prozesse, Sintering und Verkapselung.





Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Assistenzsysteme treiben die Entwicklung hochpräziser Sensorik in kompakten, robusten Packages. Wir zeigen Lösungen für effiziente Fanout-Prozesse und das aktive Alignment optischer Sensoren (CIS).





Autonomes Fahren und Car2X-Kommunikation erfordern schnellste Datenverbindungen. An extrem präzise gefertigten Silicon Photonics Transceivern demonstrieren wir Prozesslösungen für die Netzwerk- und Datenübertragungstechnik.





DEK Galaxy – Druckerlösung für Ag-Sintering und SiP-Anwendungen



AMICRA Nova+ – Produktionssystem für hochgenaue Silicon Photonics Transceiver als Kernkomponente moderner Glasfasernetzwerke und der 5G-Datenkommunikation



SilverSAM – flexible, skalierbare Presse für das Sintern von silber- oder kupferhaltigen Pasten mit SiC oder GaN Dies als Grundlage für temperaturbeständige Verbindungen in der Leistungselektronik (IGBTs etc.)

ASM PT | www.asmpacific.com AMICRA | www.amicra.com NEXX | www.asmnexx.com ALSI | www.alsi.asmpt.com

ASM Backend Systems Europe
Rupert-Mayer-Straße 44 | 81379 München | Deutschland
Telefon: +49 89 20800-27819 | E-Mail: smt-solutions.de@asmpt.com

www.asm-back-end-systems.com

Ausgabe 1/11-2019 | Änderungen vorbehalten | Bestell-Nr.: A10011-ASM-F16 | Gedruckt in Deutschland © ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.